

α-オレフィン系材料を使用しており、従来のシリコン系材料で懸念されていた低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害を引き起こしません。

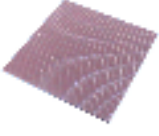
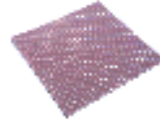
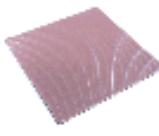
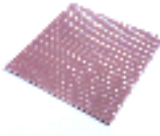
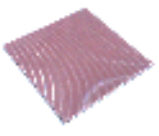
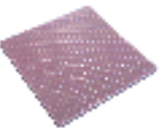
“ シリコンフリー放熱シート ”

【特徴】

- 発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ、使用します。
(熱源と放熱体の間に挟んで使用します。)
- 発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)とのすき間(ギャップ)や凹凸を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。
- 熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。
また、難燃性を有し、作業性・加工性に優れた放熱シートです。
- 柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。
- 復帰性が良好でリワーク性に優れます。
- 用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。
- 装着に便利な片面粘着タイプです。
- 公差の吸収など設計に有効に活用できます。
- RoHS指令準拠。

【用途】

- 電気部品の熱対策。
- 基板等の熱対策。
- あらゆる発熱体の放熱対策。

外観	-						
型番	-	WW-SF-B05	WW-SF-S05	WW-SF-B10	WW-SF-S10	WW-SF-B20	WW-SF-S20
寸法	mm	100×100	50×50	100×100	50×50	100×100	50×50
厚さ	mm	0.5	0.5	1.0	1.0	2.0	2.0
ベースポリマー		α-オレフィン					
熱伝導率	W/m・K	2.0					
硬さ	JIS Type E	35					
比重	-	1.8					
体積抵抗値	Ω・cm	≥1×10 ¹⁰					
絶縁破壊電圧	AC kV/mm	≥10					
耐電圧	AC kV/mm	≥10					
使用温度範囲	°C	-40~110					
難燃性	UL 94	V-0					
備考		片面粘着					
JANコード		4524945012004	4524945012011	4524945012028	4524945012035	4524945012042	4524945012059

低分子シロキサン電気接点障害とは

従来のシリコン系材料では、発熱体の動作熱により、低分子シロキサンが発生し、電気接点障害を誘発することがあります。誘発する例としては、リレーの接点不良が多く、密閉された環境下でシリコンを使用していると、シロキサンが発生し、リレー接点上に付着します。

特にON/OFF回数の多いリレーは接点のON/OFFを繰り返すことにより、接点上に衝撃を与え、接点上に付着したシロキサンを酸化分解させ、二酸化ケイ素(SiO₂)となり、電気絶縁物として作用し、接点障害を引き起こします。

本製品は、シリコン系材料を使用せず、α-オレフィン系材料を使用しておりますので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害を引き起こしません。

株式会社ワイドワーク
TEL: 03-5818-7532
FAX: 03-5818-7533
mail: satoh@widework.co.jp